

# 碳化硅激光划片氮化硅激光切割打孔刻槽改小加工支持定制

产品名称	碳化硅激光划片氮化硅激光切割打孔刻槽改小加工支持定制
公司名称	北京华诺恒宇光能科技有限公司
价格	30.00/件
规格参数	品牌:华诺激光 加工方式:激光切割加工 加工材质:半导体材料、硅片、晶圆
公司地址	北京市丰台区南三环西路88号花卉研究中心2102号
联系电话	13011886131

## 产品详情

传统式硅片切割方式就是机械切割，速度比较慢、横断面整齐能力差、残片多、不环保。硅是一种非金属材料，机械切割非常容易使边沿造成裂开，造成硅表面弹性应变区、位错网络区和碎晶区的组成层损伤，乃至可能导致隐型裂痕，危害电荷主要参数等伤害。激光切割技术具备零接触、无机械应力、割缝总宽小、横断面整齐光洁、\*\*度高、速度更快、质量稳定等优点；不容易损害单晶硅片构造，电荷主要参数要好于传统机械切割方法，可用于大规模电池片开展划片、打孔、激光切割，保证精准操纵激光切割精密度及薄厚，进一步降低激光切割碎渣，提升电池使用率。